

Press Information

2026年06月11日

日機装、「第32回 半導体・オブ・ザ・イヤー2026」を初受賞 SiCパワー半導体の接合に用いる「3Dシンター」が高評価を獲得

日機装株式会社（以下「日機装」）は、「SiCパワー半導体向け高生産加圧焼結装置 3Dシンター」が、「半導体・オブ・ザ・イヤー2026」の半導体製造装置部門において「優秀賞」を受賞しましたことをお知らせします。授賞式は2026年6月10日（水）に東京ビッグサイトにて行われ、賞を主催する産業タイムズ社による表彰と、受賞企業によるプレゼンテーションが行われました。なお、日機装における本賞の受賞は今回が初となります。

「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、開発の斬新性や量産体制の構築、社会に与えたインパクト、将来性などの基準に基づき、産業タイムズ社が発行する電子デバイス産業新聞の記者による投票で選出されます。

■受賞製品「3Dシンター」について

SiCパワー半導体の基板への接合工程において、SiCチップと基板を熱と圧力により接合（シンタリング）する装置です。日機装独自の「3Dプレス方式」を用いた特殊ゲル状加圧媒体による立体的なプレスで、高さが異なるチップや基板を、均一に一括接合できる点が特長です。これにより、従来の平面で加圧するメタルプレス方式と比べ、効率かつ高品質なモジュールの製造が可能となります。

日機装のホームページでは、3Dシンターの特長を動画等で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。

<https://www.nikkiso.co.jp/products/industrial/sintering/3d.html>

■今後の展開

昨今、AI（人工知能）やEV（電気自動車）の急速な利用拡大に伴い、従来の半導体よりも耐圧性に優れ、大電流を安定して流すことが可能なSiCパワー半導体の需要が高まっています。日機装は今後も、SiCパワー半導体のさらなる生産性・品質向上に向け、お客様のご要望に応じた製造装置の開発に励んでまいります。



授賞式での記念撮影



シンターシリーズ 3Dシンター

■「半導体・オブ・ザ・イヤー」について

第32回を迎えた「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、半導体デバイス部門、半導体製造装置部門、半導体用電子材料部門の3部門で選定が行われます。今回は2025年4月～2026年3月の間に新製品（バージョンアップ等を含む）として発表された製品・技術、および電子デバイス産業新聞で紹介された新製品の中から同紙記者の推薦、自由応募を含めて候補製品・技術が選出され、厳正なる記者投票により選出されました。受賞者の一覧は産業タイムズ社のホームページをご覧ください。

<https://www.sangyo-times.jp/seminarDtl.aspx?ID=649>

<日機装 会社概要>

会社名： 日機装株式会社
本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー22階
創業： 1953年12月26日
代表者： 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一
事業内容： 産業用特殊ポンプ・システム、医療機器、航空機部品等の製造・販売
URL: <https://www.nikkiso.co.jp/>

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係者からのお問い合わせ>

日機装株式会社 コーポレート本部 経営企画部 広報グループ

TEL： 03-3443-3717 E-mail： nikkiso-pr@nikkiso.co.jp